证券代码：300456　　证券简称：赛微电子　　公告编号：2026-009

北京赛微电子股份有限公司 2025年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年3月26日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》。

为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司的2025年年度报告全文、摘要及相关文件将于2026年3月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露。

其中，公司已于2025年7月完成对原全资子公司Silex Microsystems AB（以下简称“瑞典Silex”）控制权的出售，本次股权交易完成后，瑞典Silex由公司全资子公司转变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，由此产生的非经常性损益对本报告期归属于上市公司股东的净利润产生重大影响；上述股权交易是公司本报告期营业收入（减少）以及归属于上市公司股东的净利润（增长）大幅波动的主要原因。

敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：300456　　证券简称：赛微电子　　公告编号：2026-012

北京赛微电子股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以732,213,134为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	赛微电子	股票代码	300456
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张阿斌	孙玉荣	
办公地址	北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室、北京市北京经济技术开发区科创八街21号院1号楼	北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室、北京市北京经济技术开发区科创八街21号院1号楼	
传真	010-59702066	010-59702066	
电话	010-82252103	010-82251527	
电子信箱	ir@smeiic.com	ir@smeiic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是以MEMS纯代工模式为理念、特色工艺和制造能力为基础、国际化运营为侧重的半导体专业服务厂商。公司通过长期积累掌握MEMS制造核心工艺技术，并努力向硅光、射频、模拟等特色工艺技术进行延伸拓展；公司同时向客户提供IC设计服务及EDA工具服务，MEMS等特色工艺开发、集成、晶圆制造及封装测试服务。报告期内，公司服务客户包括硅光子、激光雷达、运动捕捉、光刻机、DNA/RNA测序、高频通信、AI计算、ICT、红外热成像、计算机网络及系统、社交网络、新型医疗设备厂商以及各细分行业的领先企业和众多知名芯片设计公司，涉及代工和服务芯片品类范围覆盖了通信计算、生物医疗、工业汽车、消费电子等诸多应用领域。公司已初步构建MEMS封装测试能力，前瞻性布局IC设计服务及EDA工具服务，致力于为客户提供从设计服务及EDA工具、工艺开发、晶圆制造到封装测试的一站式综合服务，并将着重立足本土，拓展国际化运营。

报告期内，公司从事的主要业务为MEMS纯代工、IC设计服务，以及基于存量设备继续开展部分半导体设备业务。同时，公司围绕半导体主业持续开展产业投资布局，对实体企业、产业基金进行参股型投资。

报告期内，为公司贡献业绩的业务主要为MEMS纯代工、IC设计服务。公司MEMS纯代工与IC设计服务面向各芯片设计企业客户；区别于芯片设计公司的产品销售逻辑，公司不涉足自有芯片品牌的研发和设计，不通过销售芯片产品实现收入，而是形成以MEMS纯代工服务能力为核心的业务定位，有效保护客户核心IP及设计方案，保障与客户合作关系的纯粹性与稳定性。

1、MEMS纯代工业务

公司MEMS纯代工包括工艺开发与晶圆制造。MEMS工艺开发是指根据客户提供的芯片设计方案，以满足产品性能、实现产品“可生产性”以及平衡经济效益为目标，利用工艺技术储备及项目开发经验，进行产品制造工艺流程的开发，为客户提供定制的产品制造流程。MEMS晶圆制造是指在完成MEMS芯片的工艺开发，实现产品设计固化、生产流程固化后，为客户提供批量晶圆制造服务。

2、IC设计服务业

公司IC设计服务业务，是指以芯片设计公司为主的客户在提出芯片具体功能要求后，公司协助其进行相关产品定义、架构设计、工艺选型、IP选型、电路设计、仿真、物理设计以及量产流片等相关设计服务工作。同时，基于客户需求，公司也开始向客户少量提供EDA软件开发和技术支持服务。

3、半导体设备业务

近年来，为应对国际政治经济环境可能发生的极端变化，公司旗下子公司曾从境外战略性采购了多批次半导体设备进行储备使用，根据公司业务发展的实际需要及环境变化，开展了部分与半导体设备相关的销售业务，在服务集团旗下FAB产线设备使用需要的同时，也根据市场需求服务于其他半导体制造企业，对外销售半导体设备。报告期内，公司基于存量继续开展部分半导体设备业务。

（二）公司所处行业的整体发展情况、行业政策及对公司的影响

1、集成电路行业的整体发展情况、行业政策

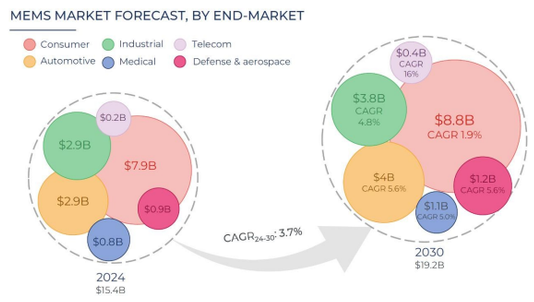
集成电路是信息处理和计算的基础，在科技革命和产业变革中发挥着关键作用。集成电路行业处于电子产业链的上游，其发展速度与全球经济增速正相关，呈现出周期性的波动趋势。2025年集成电路行业呈现全球市场稳步复苏、AI与先进工艺双轮驱动增长的态势。根据国际权威研究机构Gartner初步统计数据显示，2025年全球半导体市场营收总额达7,930亿美元，同比增长21%。其中，人工智能（AI）相关半导体（含处理器、高带宽内存HBM及网络组件）成为核心增长引擎，贡献了近三分之一的市场销售额；与此同时，AI基础设施支出持续攀升，预计到2026年将突破1.3万亿美元，进一步为行业增长注入动力。

从中长期看，集成电路是一个繁荣向好的行业。近年来，国家大力支持集成电路行业创新发展。以《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》为统领，中国形成对集成电路产业发展的总体方向指引，并在此基础上出台了一系列支持集成电路产业发展的财税政策。如北京市政府在《2025年市政府工作报告重点任务清单》中提出：大力推进集成电路、人工智能等九大专项攻关行动，着力提升共性技术供给能力，在人工智能、商业航天等领域突破一批关键核心技术。如2023年中央经济工作会议精神指出：“要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。完善新型举国体制，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加强质量支撑和标准引领，提升产业链供应链韧性和安全水平。要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。”2025年7月，工信部等七部门在《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》中提出：“创新基于光、电、磁、超声、化学的新型脑信号传感器，突破单模态信号局限，提高脑信号感知能力”等。2025年“十五五”规划提出：“完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。突出国家战略需求，部署实施一批国家重大科技任务。加强基础研究战略性、前瞻性、体系化布局，提高基础研究投入比重，加大长期稳定支持。强化科学研究、技术开发原始创新导向，优化有利于原创性、颠覆性创新的环境，产出更多标志性原创成果。”因此，基于集成电路行业整体发展长期向好的态势以及国家的长期战略政策支持，公司业务的进一步发展将继续拥有良好的产业发展及政策支持环境。

（1）MEMS行业发展情况、行业政策

MEMS是微电路和微机械按功能要求在芯片上的一种集成，基于光刻、腐蚀等传统半导体技术，融入超精密机械加工，并结合力学、化学、光学等学科知识和技术基础，使得一个毫米或微米级的MEMS具备精确而完整的机械、化学、光学等特性结构。MEMS行业系在集成电路行业不断发展的背景下，传统集成电路无法持续地满足终端应用领域日渐变化的需求而成长起来的。随着微电子学、微机械学以及其他基础自然科学学科的相互融合，诞生了以集成电路工艺为基础，结合体微加工等技术打造的新型芯片，而终端应用市场的扩张，使得MEMS应用越来越广泛，产业规模日渐扩大，成为集成电路行业一个日趋活跃的新分支。

随着万物互联与人工智能的兴起，作为集成电路细分行业的MEMS获得了更广阔的市场空间和业务机会。传统的传感器、执行器和无源结构器件逐步被替代，MEMS技术的渗透率得以进一步提高。根据世界权威半导体市场研究机构Yole Development发布的《Status of the MEMS Industry 2025》，全球MEMS市场规模将由2024年的154亿美元增长至2030年的192亿美元，CAGR（年均复合增长率）为3.7%。



图片来源：Yole Development

MEMS属于国家鼓励发展的高新技术产业和战略性新兴产业，是当前国际竞争和科技攻关的前沿热点。国家“十四五”规划纲要提出：“打造数字经济新优势，加强关键数字技术创新应用，聚焦传感器等关键领域。”与此同时，以高水平现代化生产力（新类型、新结构、高技术水平、高质量、高效率、可持续的生产力）为衡量标准，以“领域新、技术含量高，依靠创新驱动”为评判关键，MEMS属于新质生产力的范畴，将助力推动相关产业的发展，增强产业创新能力和国际竞争力。2026年初，国家“十五五”规划又进一步提出：“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。”“深入推进数字中国建设提升数智化发展水平。”近年来，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，从关键技术研发、产业应用等角度大力支持促进行业发展，为行业的发展提供了良好的政策环境。

集成电路及MEMS行业部分相关政策

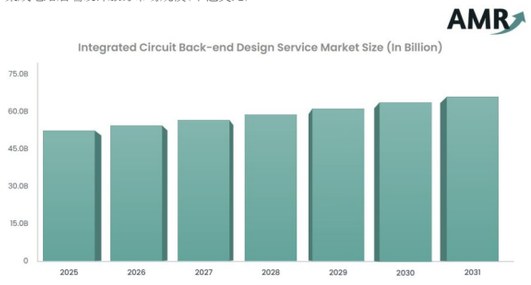
发布时间	政策名称	发布单位	主要内容
2023.1	《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	工信部等六部门	发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，集成多维度信息采集能力的高端传感器，新型MEMS传感器和智能传感器。
2023.1	《“机器人+”应用行动实施方案》	工信部等十七部门	推动机器人技术与5G、云计算、智能传感等新技术融合，实现自主导航、自动避障、人机交互、语音及视觉识别、数据分析等功能。
2023.12	《产业结构调整指导目录（2024年本）》	国家发改委	推动制造业高端化、智能化、绿色化。以下内容列为鼓励类技术、装备及产品：集成电路；线宽小于0.25微米（含）的特色工艺集成电路生产；传感器封装（MEMS、2.5D、3D等一种或多种技术集成的先进封装与测试；传感器；微纳位移传感器、柔性触觉传感器、高分辨率视觉传感器、可加密传感器等具有无线通信功能的低功耗智能传感器。
2024.1	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	工信部等七部门	突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用；加快突破CPU芯片、集群低时延互连网络、异构资源管理等技术，建设超大规模智算中心，满足大模型迭代训练和应用推理需求。
2024.3	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	国务院	促进产业高端化、智能化、绿色化发展；推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造；开展汽车以旧换新；鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴；积极培育智能家居等新型消费。
2024.5	《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》	国家发改委等四部门	加快推动城市建筑、道路桥梁、园林绿地、地下管廊、水利水务、燃气热力、环境卫生等公共设施数字化改造、智能化运营，统筹部署泛在物联的城市智能感知终端；推进城市智能基础设施与智能网联汽车协同发展。
2024.12	《关于深化养老服务改革发展的意见》	中共中央、国务院	研究设立养老服务相关国家科技重大项目，重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。深化全国智慧健康养老应用示范，推广智能化家居和智慧健康产品，探索开展居家养老安全风险预警和防范服务。
2025.8	《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	国务院	为深入实施“人工智能+”行动，推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，重塑人类生产生活范式，促进生产力革命性跃迁和生产关系深层次变革，加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态。
2025.9	《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》	工信部、市场监督管理总局	加强电子信息领域制造业创新中心等创新平台建设，强化行业关键共性技术供给。通过国家重点研发计划相关领域重点专项，持续支持集成电路、先进计算、未来显示、新型工业控制系统等领域科技创新。
2026.1	《关于进一步提升北京市中试服务能力促进科技创新和产业创新融合发展的若干措施》	北京市发改委、北京市经信局、北京市科委等	提升中试平台全链条服务能力。引导技术创新类、成果转化与产业化类创新平台拓展技术熟化、工程化放大和可靠性验证功能。鼓励平台以中试功能为基础，加快形成覆盖技术挖掘、技术熟化、产品试制、工艺创新、试验验证、检验检测、市场对接、资金筹集等功能的产业链全链条服务能力。支持市级重大中试平台、中试产线、中试孵号工厂提升产品创制能力。
2026.3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》	全国人民代表大会、国务院	加强原始创新和关键核心技术攻关。坚持技术驱动和需求拉动相结合、锻长板和补短板相结合，完善新型举国体制，推动产出更多标志性原创成果，打好关键核心技术攻坚战。强化战略前沿领域科技布局。全面提升基础研究水平。强化企业科技创新主体地位。落实企业在技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化应用中的主体地位，促进创新链产业链资金链人才链深度融合。推动创新资源向企业集聚。加强企业主导的产学研融通创新。完善促进企业创新的政策体系。

（2）IC设计服务行业发展情况、行业政策

随着芯片集成度的不断提升，集成电路行业进入后摩尔时代，芯片性能单纯依靠制程微缩进行提升已面临瓶颈，产业发展也从早期的IDM一体化模式逐步走向高度专业化分工，IC设计服务与EDA软件开发正是在这一产业演进过程中应运而生的。当下，芯片设计涉及前端设计及验证、逻辑综合、时序分析、物理实现、版图验证、功耗优化、可靠性设计等大量复杂环节，仅仅依靠芯片设计企业自身团队已难以覆盖全部流程，为提升设计效率、降低研发成本、缩短产品上市周期，专业化的IC设计服务逐步从产业链中独立出来，成为连接芯片设计与制造的关键环节和重要能力补充。与此同时，为实现芯片自动化设计、逻辑仿真、电路综合、布局布线、寄生参数提取、设计规则检查、物理验证等工作，以计算机辅助设计（CAD）为基础的电子设计自动化工具逐步发展，最终形成了EDA软件开发行业。

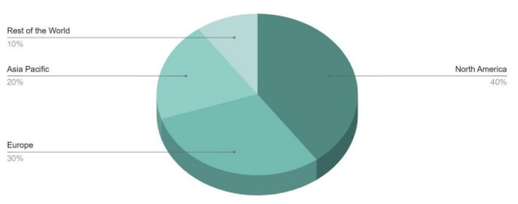
根据Archive Market Research´s Growth数据，全球集成电路后端设计服务市场规模2025年市场规模约为524亿美元，到2031年市场规模将增长至约660亿美元。其中，亚太地区的集成电路后端设计服务市场正经历显著增长，市场份额占比约20%。

集成电路后端设计服务市场规模（十亿美元）



图片来源：Archive Market Research´s Growth

集成电路后端设计服务区域市场份额



图片来源：Archive Market Research´s Growth

一直以来，在IC设计服务与EDA软件开发的先进制程和关键技术领域，国外大型IC设计服务企业都居于主导地位，国内企业正奋力追赶。近年来，国内发布了一系列围绕IC设计服务与EDA软件开发行业的支持政策，重点以《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》为基础，持续强化顶层设计，推动国产IC设计服务行业与EDA国产替代。随着自主可控战略深入推进、下游算力与智能终端需求持续增长，叠加全方位政策红利，IC设计服务及EDA软件开发行业正处在高速发展期，未来前景广阔，国产替代空间巨大。

公司当前业务以MEMS纯代工为核心，并兼具IC设计服务及EDA工具服务，基于两项细分行业整体发展长期向好的态势以及国家的战略政策支持，公司业务的发展将继续拥有良好的产业空间及政策支持环境。报告期内，公司及旗下控股子公司继续获得中央及地方集成电路项目的各项政策支持，这有利于公司进一步加大相关投入，推动业务未来持续向好发展。

（三）国内外主要行业公司

MEMS芯片纯代工制造处于产业链的中游，该行业根据设计环节的需求开发各类MEMS芯片的工艺制程并实现规模生产，兼具资金密集型、技术密集型和智力密集型的特征，对企业资金实力、研发投入、技术积累等均提出了极高要求。经历汽车电子、消费电子、物联网三次发展浪潮，MEMS芯片纯代工制造行业已形成较为稳定的市场竞争格局，瑞典Silex、TELEDYNE、台积电（TSMC）、X-FAB长期保持在全球MEMS代工第一梯队。目前，公司控股子公司赛莱克斯北京投资建设的规模量产线“8英寸MEMS国际代工线”正处于产能爬坡阶段，此外国内正在建设运营MEMS代工线的公司主要有芯联集成电路制造股份有限公司、广州增芯科技有限公司、上海先进半导体制造股份有限公司、无锡华润上华科技有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、安徽华鑫微纳集成电路有限公司等。

集成电路行业的飞速发展，促进了IC设计服务及EDA软件开发需求的日益旺盛。公司控股子公司展诚科技是国内较早从事IC设计服务及EDA软件开发的资深企业，此外其他从事IC设计服务或EDA软件开发的公司主要有创意电子股份有限公司、智原科技股份有限公司、灿芯半导体（上海）股份有限公司、创耀（苏州）通信科技股份有限公司、芯原微电子（上海）股份有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、上海概伦电子股份有限公司、杭州广立微电子股份有限公司、杭州行芯科技有限公司等。

（四）公司所处的行业地位

MEMS业务方面，公司控股子公司赛莱克斯北京已投入运营并持续推动产能爬坡。赛莱克斯北京是国内领先的纯MEMS代工企业之一，在瑞典Silex控制权转让后，公司将集中资源重点发展并深化运营北京产线，随着赛莱克斯北京产能的持续爬坡，公司有望在纯MEMS代工领域仍保持重要地位。公司参股子公司瑞典Silex（2025年7月出表成为公司参股子公司）是全球领先的纯MEMS代工企业，服务于全球各领域巨头厂商，且正在瑞典持续扩充产能。根据Yole Development的统计数据，2012年至今，瑞典Silex在全球MEMS代工厂营收排名中一直位居前五，与意法半导体（ST Microelectronics）、TELEDYNE、台积电（TSMC）、索尼（SONY）等厂商持续竞争，2019-2024年则在全球MEMS纯代工厂商中位居第一。2025年7月，瑞典Silex的控制权转让事项已完成交割，但瑞典Silex仍为公司持股45.24%的重要参股子公司。

IC设计服务业务方面，公司控股子公司展诚科技是国内较早从事集成电路设计服务细分领域的头部公司，累计服务多家行业知名企业，在集成电路设计服务领域占据国内领先地位。报告期内，公司控股子公司展诚科技还在EDA软件开发方面主要从事寄生参数提取EDA软件研发，展诚科技研发的寄生参数提取EDA主要用于精确还原集成电路纳米尺寸下真实复杂的物理模型，是保证工艺研发和芯片设计成功的关键环节。展诚科技先后荣获国家重点集成电路设计企业、国家专精特新“重点小巨人”企业、山东省“瞪羚”企业、山东省电子信息行业优秀企业、山东省软件产业高质量发展重点项目等资质荣誉。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	8,939,422,428.40	7,011,337,774.25	27.50%	7,261,878,738.03
归属于上市公司股东的净资产	6,734,386,456.42	4,923,596,975.33	36.78%	5,162,100,953.14
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	824,105,934.18	1,204,715,636.91	-31.59%	1,299,682,668.54
归属于上市公司股东的净利润	1,473,454,069.63	-169,994,109.70	966.77%	103,613,168.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-341,950,113.37	-190,715,861.54	-79.30%	8,153,452.64
经营活动产生的现金流量净额	-13,906,760.08	355,594,512.77	-103.91%	144,390,831.67
基本每股收益（元/股）	2.0123	-0.2322	966.62%	0.1416
稀释每股收益（元/股）	2.0123	-0.2322	966.62%	0.1416
加权平均净资产收益率	25.27%	-3.37%	28.64%	2.04%

注：上述表格中归属于上市公司股东的净利润与基本每股收益、稀释每股收益本年比上年增减不一致，系因小数点四舍五入导致。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	264,012,302.74	306,083,480.39	111,819,836.83	142,190,314.22
归属于上市公司股东的净利润	2,642,119.76	-3,292,453.12	1,576,469,980.20	-102,365,577.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,398,865.69	-12,066,792.18	-234,970,682.04	-87,513,773.46
经营活动产生的现金流量净额	93,890,652.87	71,911,900.72	-144,371,526.22	-35,337,787.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股东及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	168,675	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	161,665	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨云春	境内自然人	24.46%	179,076,719.00	134,307,539.00	质押	71,170,000.00
					冻结	11,843,479.00
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	4.18%	30,592,393.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	13,100,772.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	4,706,939.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.45%	3,261,941.00	0.00	不适用	0.00
国泰海通证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	3,189,482.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	2,873,400.00	0.00	不适用	0.00
#宋天峰	境内自然人	0.33%	2,411,900.00	0.00	不适用	0.00
高盛国际—自有资金	境外法人	0.30%	2,183,958.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	2,136,050.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

（一）整体经营情况概述

报告期内，公司继续聚焦发展主营业务MEMS（微机电系统），并持续为下一步的产能扩充及爬坡做好准备；同时根据公司发展战略，延伸并购展诚科技，布局IC设计服务。

对于北京亦庄MEMS量产线，报告期内继续处于产能爬坡阶段，具有导入属性的工艺开发业务继续开展，带动着公司从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆产品类别持续增加。但由于部分原有量产客户订单在报告期内因下游市场需求变化产生较大波动，北京亦庄MEMS量产线的收入出现下滑。此外，北京亦庄MEMS量产线研发投入依然保持较高强度，运营支出存在刚性，叠加折旧摊销等因素，亏损较上年扩大。

对于瑞典MEMS产线（2025年7月出表成为公司参股子公司），报告期内订单、生产与销售状况良好（尤其是MEMS-OCS晶圆的生产销售在本报告期实现大幅增长），继续实现了整体业务增长，保持了良好的盈利能力。

近年来，国际地缘政治环境发生深刻变化，同时半导体产业在全球地缘政治博弈中的战略地位日益凸显，经济全球化与国际产业链分工协作面临挑战。由于国际局势的日趋紧张及复杂化，瑞典Silex面临的不确定性因素显著增加。若公司继续维持对瑞典Silex的控股地位，其业务运营与发展面临的地缘政治相关风险及不确定性可能上升，包括但不限于其与关键客户及供应商伙伴持续稳定合作的潜在挑战，以及由此可能导致的瑞典Silex经营风险和价值受损风险。为审慎应对复杂多变的国际形势，最大程度缓解地缘政治环境变化带来的系统性风险，切实维护上市公司及全体股东的长远利益，经公司慎重研究，决定出售瑞典Silex控制权，同时保留部分少数股权，继续享有瑞典Silex业务增长收益、保持境内外协作沟通纽带，并为海外业务运营创造更具韧性的发展条件。本次重大资产出售已于2025年7月完成交割，瑞典Silex从公司的全资子公司转变成为公司的重要参股子公司。

2025年9月，公司完成对展诚科技56.24%股权的收购。本次交易完成后公司合计持有展诚科技61.00%股权，展诚科技成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。报告期内，展诚科技IC设计服务保持良性发展，实现盈利。

报告期内，公司及相关子公司基于存量设备仍适度开展半导体设备业务，贡献了一定的营业收入，但由于缺乏上年的大客户销售，且国内半导体设备市场竞争加剧，公司2025年半导体设备业务较上年大幅下降了82.69%。

与此同时，报告期内公司管理费用大幅增长，主要系确认瑞典Silex因控制权出让交易触发的大额股权激励费用，剔除该因素影响后，管理费用较上年小幅增加；财务费用上升，主要系因报告期汇兑损失较上年同期增加；销售费用略有下降；资产减值损失大幅增加；研发费用略有下降但继续处于较高投入水平。

报告期内，公司实现营业收入82,410.59万元，较上年下降31.59%；实现营业利润138,017.82万元，较上年大幅增长642.79%；实现利润总额138,010.57万元，较上年大幅增长642.78%；实现净利润138,843.48万元，较上年大幅增长643.94%；归属于上市公司股东的净利润147,345.41万元，较上年大幅增长966.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,195.01万元，较上年大幅下降79.30%。

报告期内，公司基本每股收益2.0123元，较上年大幅增长966.62%；加权平均净资产收益率25.27%，较上年优化28.64%（绝对数值变动），主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润较上年大幅增长966.77%。

本报告期末，公司总资产893,942.24万元，较期初上升27.50%；归属于上市公司股东的所有者权益673,438.65万元，股本732,213,134.00元，归属于上市公司股东的每股净资产9.20元，较期初上升36.90%。

报告期内，公司2025年7月完成对原全资子公司瑞典Silex控制权的出售，本次股权交易完成后，瑞典Silex由公司全资子公司转变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，由此产生的非经常性损益对本报告期归属于上市公司股东的净利润产生重大影响；上述股权交易是公司营业收入下降、归属于上市公司股东的净利润大幅增长的主要原因。报告期内，非经常性损益对公司当期归母净利润的影响为181,540.42万元（主要影响因素为瑞典Silex控制权的出售），上年同期非经常性损益对当期净利润的影响为2,072.18万元（主要影响因素为政府补助）。

（二）主要业务情况

1、MEMS纯代工业务发展情况

报告期内，公司MEMS业务收入下降，主要系公司2025年7月完成对原全资子公司瑞典Silex控制权的出售，本次股权交易完成后，瑞典Silex由公司全资子公司转变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围；另一方面公司北京亦庄MEMS量产线的产能爬坡持续推进，除继续开展具有导入属性的工艺开发业务外，从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆代工品类持续增加，报告期内北京亦庄MEMS量产线工厂实现MEMS硅晶振及OCS（Optical Circuit Switch）的缩写，即光链路交换器件）从工艺开发到小批量试生产的推进，但由于部分原有量产客户订单在报告期内因下游市场需求变化产生较大波动，北京亦庄MEMS量产线工厂的收入出现下滑。

报告期内，公司MEMS业务实现收入68,409.97万元，较上年下降31.46%；其中，MEMS晶圆制造实现收入39,373.85万元，较上年同期下降39.98%，MEMS工艺开发实现收入29,036.12万元，较上年同期下降15.09%，上述变化的主要原因是：瑞典Silex2025年7月由公司全资子公司转变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。与此同时，由于北京亦庄MEMS量产线仍处于产能爬坡阶段，营收规模体量以及量产产品类别仍相对较少，部分原有量产客户订单在报告期内因下游市场需求变化产生较大波动，北京亦庄MEMS量产线工厂的收入出现下滑，但持续累积各领域客户及晶圆产品类别。

报告期内，公司MEMS业务的综合毛利率为37.86%，较上年同期上升2.37%；其中MEMS晶圆制造毛利率为34.50%，较上年同期基本持平，MEMS工艺开发毛利率为42.41%，较上年同期上升2.51%，上述变化的主要原因是：对于MEMS晶圆制造，随着MEMS晶圆制造业务的逐步稳定发展，原材料、人工、制造费用等形成的成本结构日趋稳定，毛利率水平趋于稳定，未来需进一步释放规模效应；对于MEMS工艺开发，2025年产品品结构较上年同期有所变化，同时公司采取了有效的成本控制手段，毛利率较上年同期有所上升。整体而言，瑞典MEMS产线（2025年7月出表成为公司参股子公司）的毛利率继续保持了较高水平，北京亦庄MEMS量产线仍处于产能爬坡阶段，其MEMS业务的综合毛利率较上年同期略有提升，公司MEMS业务最终在整体上保持了较好的毛利率水平。

报告期内，得益于MEMS应用市场的高景气度，并基于持续扩充的产线产能，公司积极开拓全球市场，并积极承接MEMS工艺开发及晶圆制造订单，持续服务于包括硅光子、激光雷达、运动捕捉、光刻机、DNA/RNA测序、高频通信、AI计算、ICT、红外热成像、计算机网络及系统、社交网络、新型医疗设备等厂商以及通信计算、生物医疗、工业汽车和消费电子等各细分领域的领先企业。

报告期内，公司瑞典MEMS产线升级改造完成后的产能逐步磨合且基于此前已收购的半导体产业园区，其自身的MEMS工艺开发及晶圆制造业务的产能保障能力均得到加强；公司北京亦庄MEMS量产线持续扩大覆盖不同的产品及客户，积极推进产能及良率爬坡，并适时逐步扩充产能。公司虽已于2025年7月完成瑞典Silex控制权出售的交割，但随着北京产线整体运营状态的持续提升，以及公司正在推进的怀柔MEMS中试线布局，公司仍拥有不同定位的合格产能，不同产线在产能、市场等方面可以实现协同互补，公司有望在纯MEMS代工领域仍保持重要地位。

2、IC设计服务业务发展情况

2025年展诚科技实现营业收入21,148.38万元，归母净利润2,216.41万元，保障提升IC设计服务业务基本盘的同时，推进了EDA软件开发。报告期内，展诚科技紧抓算力及AI芯片发展的重要机遇期，优化自身技术、夯实绑定大客户战略，大力开发新客户，实现了技术优化升级与包括海外市场的业务开拓，并提前布局3nm以下技术储备与积累。同时，展诚科技积极延伸业务赛道，力争细分领域的突破，并不断打造自身在不同芯片领域从架构设计到版图验证的一站式服务能力和全方位服务体系，关注和兼容国际主流技术、工具、格式，积极捕捉商业机遇，为将来助力客户降低研发成本、缩短上市周期做好了扎实准备。报告期内展诚科技各业务模式的发展情况如下：

（1）off-site模式发展情况

报告期内，展诚科技在off-site模式依托远程网络专业工具、安全远程协作体系的完善和普及，借助标准化的设计流程、跨地域的资源整合能力，在芯片设计、验证、标准化IP开发与验收、设计数据校验检查等项目流程中持续优化运营效率，有效降低了远程协作的沟通成本。off-site模式是展诚科技服务众多客户、承接批量标准化需求的重要模式。

（2）on-site模式发展情况

报告期内，展诚科技在on-site模式持续深化场景化适配能力，针对客户先进工艺节点芯片设计、高复杂度混合模块等对实时协同、工艺深度对接要求高的需求，进一步强化驻场团队的专业配比度，提升快速响应速度，通过与客户的无缝联动，在项目中实现了高效协作和高质量交付。on-site模式是展诚科技IC设计服务业务发展的重要模式。